

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2026-005

# 上海新阳半导体材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 312050178 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.8 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	上海新阳	股票代码	300236
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨靖	张培培	
办公地址	上海市松江区思贤路 3600 号	上海市松江区思贤路 3600 号	
传真	021-57850620	021-57850620	
电话	021-57850066	021-57850066	
电子信箱	info@sinyang.com.cn	info@sinyang.com.cn	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### （一）公司业务及产品

公司始终坚持自主研发，持续进行技术创新，经过二十多年发展，主要形成两大类业务，一类为集成电路制造及先进封装用关键工艺材料及配套设备的研发、生产、销售和服务，并为客户提供整体化解

决方案。另一类为环保型、功能性涂料的研发、生产及相关服务业务，并为客户提供专业的整体涂装业务解决方案。主要产品包括：

(1) 晶圆制造及先进封装用电镀液及添加剂系列产品

晶圆制造及先进封装用电镀液和添加剂系列产品为公司面向芯片制造领域开发的第二代电子电镀产品。包括大马士革铜互连、TSV、Bumping 电镀液及配套添加剂。

(2) 晶圆制造用清洗液系列产品

晶圆制造用干法刻蚀后清洗液以及研磨后清洗液系列产品为公司面向芯片制造领域开发的电子清洗液系列产品。包括铜制程刻蚀后清洗液、铝制程刻蚀后清洗液、化学机械研磨后清洗液等。

(3) 集成电路制造用高端光刻胶系列产品

集成电路制造用高端光刻胶系列产品为公司面向芯片制造领域开发的电子光刻系列产品。包括 I 线光刻胶、KrF 光刻胶、ArF 干法、浸没式光刻胶以及稀释剂、底部抗反射膜 (BARC) 等配套材料，主要用于逻辑、模拟和存储芯片生产制造。

(4) 晶圆制造用化学机械研磨液系列产品

公司化学机械研磨液主要包括适用于浅槽隔离研磨液 (STI Slurry)、金属钨研磨液 (W Slurry)、金属铜研磨液 (Cu Slurry)、硅氧化层研磨液 (Oxide Slurry)、多晶硅层研磨液 (Poly Slurry) 等系列产品，研磨液产品可覆盖 14nm 及以上技术节点。

(5) 晶圆制造用蚀刻液系列产品

晶圆制造用蚀刻液系列产品为公司面向存储芯片制造领域开发的电子蚀刻系列产品。包括用于 3D NAND/DRAM 存储器芯片制造的氮化硅/钛等蚀刻系列产品。

(6) 半导体封装用电子化学材料

半导体封装用电子化学材料为用于半导体引线脚表面镀锡的化学材料及其配套电镀前处理、后处理化学材料，是公司面向传统封装领域开发的第一代电子电镀与电子清洗产品，包括无铅纯锡电镀液及添加剂、去毛刺溶液等。

(7) 配套设备产品

配套设备产品包括半导体封装引线脚表面处理配套电镀、清洗设备和先进封装制程用电镀、清洗设备。

(8) 氟碳涂料产品系列

环保、功能性氟碳涂料包括：PVDF 氟碳粉末涂料、氟碳喷涂涂料、氟碳辊涂涂料、超细耐候粉末涂料等。

## (二) 主要经营模式

## 1、研发模式

作为研发驱动型企业，公司始终围绕自身的核心技术，面向集成电路产业当前和未来需求，以自主研发、自主创新为主，开展集成电路制造用关键工艺材料的研发和产业化。始终坚持以技术主导为核心，持续研发创新，积极融入国家创新体系。通过自主评估并结合国家科技重大专项的需求设立研发项目，开展产品开发、应用技术开发和生产工艺开发。同时与客户保持密切合作，针对性研发满足客户需求的产品，为其开发创新性的解决方案。通过对产品性能的不断优化及应用和生产工艺的提升，持续满足客户的需求。

## 2、采购模式

公司根据 ISO 质量体系要求，制定了《采购控制程序》，采购流程、供应商管理流程做到规范化、系统化。

a. 一般材料需求部门根据计划或者实际情况提交采购申请，实行采买；

b. 原材料采购由需求部门提出需求，由质量部、技术中心共同评估材料的指标性能，招标后从合格供应商处采购，确保稳定供应；

c. 固定资产和工程类采购由相关部门参与评审，招标后按合同约定开展。

## 3、生产模式

公司采用以销定产的方式确定生产量。计划部月初根据市场部订单情况以及备货策略编制当月生产计划，生产部合理安排，实施当月生产。每周生产部和计划部还会依据市场订单的变化及生产进度调整生产计划，在满足客户产品需求的同时，提高产品周转率。

## 4、销售模式

公司采用的是直销模式。公司在半导体材料领域深耕二十多年，积累了良好的客户资源，并形成了良好的合作关系。公司市场部负责跟进、整理公司所属行业发展情况，制定公司市场战略规划，制定公司业务目标以及产品市场开发和销售工作计划。市场部人员负责与客户进行合同签订、订单确认、评审、发货计划、产品运输等各项工作，持续为客户提供优质的产品和服务。

## 5、服务模式

公司在集成电路制造用关键工艺材料及设备领域深耕细作，在为客户提供优质产品的同时，更能为客户提供化学材料、配套设备、应用工艺和现场服务一体化的整体解决方案，快速响应客户需求，多方位整合公司资源，创新研发，为客户带来丰富和优质的服务方案，提升客户端产品竞争力。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

元

	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
总资产	6,958,803,297.00	5,860,673,166.39	18.74%	5,588,589,806.19
归属于上市公司股东的净资产	5,153,696,324.76	4,536,694,935.49	13.60%	4,188,533,225.02
	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入	1,936,684,874.79	1,475,183,325.30	31.28%	1,212,420,426.53
归属于上市公司股东的净利润	300,672,947.50	175,708,529.19	71.12%	166,840,625.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	274,078,187.39	160,765,402.17	70.48%	123,070,944.40
经营活动产生的现金流量净额	475,102,085.78	224,741,098.52	111.40%	151,385,721.60
基本每股收益（元/股）	0.9647	0.5654	70.62%	0.5389
稀释每股收益（元/股）	0.9647	0.5654	70.62%	0.5389
加权平均净资产收益率	6.18%	4.21%	1.97%	3.74%

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	433,912,779.66	462,736,892.25	497,031,267.60	543,003,935.28
归属于上市公司股东的净利润	51,181,899.33	82,123,430.01	77,815,766.68	89,551,851.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,199,124.98	79,834,551.17	70,036,444.48	77,008,066.76
经营活动产生的现金流量净额	13,579,659.06	99,213,594.76	159,722,610.87	202,586,221.09

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

### 4、股本及股东情况

#### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	46,143	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,689	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
王福祥	境内自然人	14.37%	45,032,070.00	33,774,052.00	不适用				0.00
上海新晖资产管理 有限公司	境内非 国有法 人	12.10%	37,933,276.00	0.00	不适用				0.00
上海新科投资 有限公司	境内非 国有法 人	6.63%	20,788,086.00	0.00	质押				8,410,000.00
孙慧明	境内自然人	3.68%	11,529,999.00	0.00	不适用				0.00
SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD	境外法 人	2.30%	7,216,290.00	0.00	不适用				0.00
金叶飞	境内自然人	2.25%	7,047,432.00	0.00	不适用				0.00
香港中央结算 有限公司	境外法 人	1.55%	4,858,871.00	0.00	不适用				0.00
全国社保基金 四一一组合	其他	1.55%	4,857,707.00	0.00	不适用				0.00
杨燕灵	境内自然人	1.29%	4,053,600.00	0.00	不适用				0.00
金叶玲	境内自然人	0.95%	2,981,690.00	0.00	不适用				0.00
上述股东关联关系 或一致行动的说明	股东王福祥、上海新晖资产管理、上海新科投资有限公司为关联股东，属于一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否有关联关系和一致行动人情况。								

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

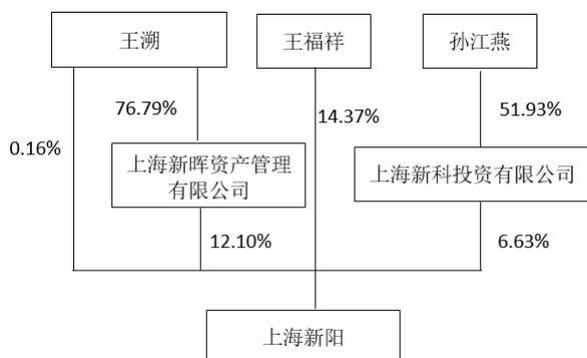
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

## 三、重要事项

2025 年度，在全球经济复苏不均衡、地缘政治博弈加剧、行业需求旺盛的复杂背景下，公司在董事会的战略引领与经营管理团队的高效管理下，聚焦主业，积极谋划部署各项工作，使公司整体运营水平进一步提高。在业务拓展上，公司充分发挥自身在技术开发、产品与客户服务方面的核心优势，围绕五大核心技术与产品，持续突破提升产品性能，积极落实市场开拓计划，在核心技术领域，深化与重点客户合作。在研发、生产和销售等方面都取得了显著成绩，进一步提升了公司在集成电路材料领域的市场地位。

报告期内，公司实现营业收入 19.37 亿元，较去年同期增长 31.28%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.01 亿元，同比增长 71.12%，扣除非经常性损益后净利润为 2.74 亿元，同比增长 70.48%。公司半导体行业实现营业收入 15.17 亿元，同比增长 46.50%，主要是公司集成电路制造用关键工艺材料产品技术优势日益凸显，产品类型不断丰富，新产品市场开发进展顺利，取得客户订单数量持续增加。报告期内，公司晶圆制造用关键工艺材料销量增加较多，其中，晶圆制造用电镀液及添加剂系列产品市场份额持续增长，集成电路制造用清洗、蚀刻系列产品在客户端拓展顺利，销售规模快速增加。涂料板块业务，2025 年度经营态势稳健，全年实现营业收入 4.19 亿元，受行业经济度及内卷困局影响，净利润同比下滑。

## 1、坚守创新之路，实现能力跃迁

公司坚定不移地贯彻执行以技术为主导的发展战略，始终坚持自主研发，持续创新；始终坚持面向产业需求，面向前沿技术，面向国内空白，面向进口替代的战略定位。报告期内，随着产业的快速发展以及与客户协同的逐步加深，围绕客户新材料、新工艺的迫切需求，公司在五大核心技术领域持续加大研发投入，创新产品技术，满足客户“材料+工艺参数+设备适配”的一体化方案需求，公司实现从替代走向原创设计与性能定义的能力跃迁。报告期内公司研发投入总额 2.69 亿元，较上年同期增加 22.37%，占本期营业收入的比重为 13.91%，主要集中于集成电路制造用光刻胶、先进制程蚀刻液、清洗液、添加剂、化学机械研磨液等项目开发。

在集成电路制造及先进封装材料领域，公司自主开发的用于芯片铜互连的电镀系列产品——大马士革工艺材料、硅通孔工艺（TSV）材料广泛应用。近年来随着存力算力需求、AI 技术的快速发展，先进封装技术的需求快速增长，TSV 技术作为先进封装的核心工艺，通过与 2.5D/3D 封装、异构集成等技术的深度融合，成为推动芯片性能与集成度跃升的关键路径。经过多年的开发创新与技术储备，公司研发并量产的适用于 TSV 工艺的铜互连电镀添加剂，已经实现 3D-TSV 中微孔高效电镀填充，深宽比可达 20:1，且电镀均匀性、可靠性良好。随着先进封装工艺技术的日趋成熟，公司与客户合作度的加深，公司电镀液及其添加剂相关产品销售规模持续提升，报告期内公司电镀液及添加剂系列产品销售额与去年同期相比增长 40%。

在集成电路制造用清洗液产品方面，公司干法刻蚀后清洗液产品已经实现 14nm 及以上技术节点全覆盖。报告期内干法刻蚀后清洗液产品销售规模不断扩大，先进制程清洗液技术持续迭代，广泛应用于逻辑电路、模拟电路、存储器件等晶圆制造客户。公司凭借先进的技术优势及市场服务，晶圆制造用铜/铝制程刻蚀后清洗系列产品报告期内销售额快速增加，同比增长超 50%，持续巩固了公司晶圆清洗系列产品市场地位。

蚀刻液用于在晶圆加工过程中选择性去除特定材料（如硅、二氧化硅、金属等），以形成电路图案，尤其在复杂图形加工和特定材料处理方面具有不可替代的作用。公司原创开发的用于芯片制造的蚀刻液产品，自 2018 年立项以来历经三年技术攻关，实现四代技术产品的开发及迭代升级，可满足最大纵深比 1:200 的复杂图形的高精度蚀刻，达到蚀刻后图形的均匀性和平整性要求。目前公司已有三代技术产品实现规模化市场销售，开发出的适用于全世界最高水准的 3D NAND 存储芯片的高选择比氮化硅蚀刻液，选择性蚀刻速率最高可达 2000:1，报告期内蚀刻液市场应用规模进一步扩大，较上年同期增长超 80%。针对半导体产业快速更新迭代的需求，公司研发团队持续纵深开发，做好前瞻性的材料研究和技术储备，针对 3D NAND、DRAM 存储工艺需求的蚀刻类配方型化学品技术积极布局重点开发，助力国产下一代存储芯片持续领先。

光刻胶作为晶圆制造环节中的重要关键材料，长期以来被日本、欧美等海外企业所垄断。公司作为集成电路制造用关键工艺材料研发型企业，致力于推动高端光刻胶及配套产品国产化进程，依托自身的技术实力和持续的研发投入，已建成包括 I 线、KrF、ArF 干法、ArF 浸没式各类光刻胶在内的完整的研发合成、配制生产、质量管控、分析测试平台，能为国内芯片企业提供多品类光刻胶产品，部分品类已实现产业化，少数品类关键光学数据处行业领先水平，公司已成为国内光刻胶供应链中重要一环。报告期内，公司光刻胶已有多款产品实现批量化销售，销售规模较上年同期增长 30%以上。

在集成电路用化学机械研磨液技术与产品开发方面，产品研发、生产工艺、分析检测、技术应用、客户服务等工作进展迅速，成熟的 STI slurry、Poly slurry、W slurry 等系列产品可覆盖 14nm 及以上技术节点，在客户端测试验证顺利，报告期内研磨材料销售额较上年同期增长 160%。其中，先进制程 Poly slurry 产品已进入国内主流晶圆公司产线，产品性能优越，打破了国外对该产品的垄断，为研磨液产品的量产销售及未来发展奠定基础。

公司多年来始终坚持自主创新，注重研发技术积累与市场开拓能力提升，围绕公司五大核心技术持续创新，通过与产业链上下游协同发展，不断攻克被“卡脖子”关键工艺材料产品技术难关，已实现从“集成电路关键工艺材料行业跟跑者变成局部领跑者”，公司在集成电路制造用关键工艺材料领域的竞争力不断提升。

## 2、半导体业务扩张，助国产力量崛起

半导体行业的发展对科技和经济发展具有重要意义。随着整个半导体产业规模的持续增长以及中国大陆新建代工产能的不断增加，中国大陆半导体市场规模增速将会持续增加，叠加我国国产替代以及 AI 浪潮驱动，国内半导体材料市场必将迎来充满机遇的蓬勃发展期。面对行业需求的快速提升，公司制定了未来三年发展战略规划，持续聚焦“业务规模做大、技术能力做强、行业地位做高，成为半导体材料行业引领者”的发展战略。报告期内，公司布局建设的集成电路制造用关键工艺材料产品仍然面临旺盛的市场需求，2025 年全年公司集成电路材料总销量 2.85 万吨，较去年同期增长了 45%，其中晶圆制造用化学材料产品销量占比超 80%。

为了进一步巩固公司在国内半导体材料行业的领先地位，公司结合市场需求变化情况及整体发展规划，通过调整合肥新阳产能布局，提升合肥产能产量，合肥新阳扩产项目已完成立项以及环环评等审批手续，已完成部分产线建设，即将进入调试及试生产阶段。同时，公司稳步推进上海化学工业区项目建设。此外，上海松江本部 128 亩年产 50000 吨集成电路关键工艺材料及总部、研发中心项目，年内立项、年内开工，目前进展顺利。随着公司在半导体业务产能方面布局的持续加深，新产能的陆续建成投产，公司产能规模的不断释放，能够满足未来市场需求的增长，助推公司未来发展战略规划的逐步实现。

## 3、优化管理体系，内化半导体气息

2025 年处于上海新阳拓展提升的发展阶段。公司持续围绕技术引领、产品引领、市场引领的战略目标，持续创新、创造，打造自身技术引领优势，赋能公司未来发展战略，成为半导体材料行业引领者。

2025 年是公司持续深化落实“半导体气息”管理理念的一年，不断内化“专业、认真、务实、执行力”的工作作风，提高公司核心竞争力。公司高度注重提升企业运营管理能力，不断优化完善管理体系，提升市场规划、供应链管理、质量管理、安全生产、运营效率等方面运行水平，强化信息安全管控，常态化信息管控等工作，为公司数据资产安全、业财融合转型筑牢数字化防线。此外，新阳 AI 材料科学家平台上线，初步形成企业级 AI 能力体系，为未来公司业务数字化、智能化、高质量发展提供坚实支撑。

随着业务规模的不断扩大，技术开发难度不断提升，公司高度重视人才储备和团队专业能力培养提升工作。公司结合行业需求及发展规划，组建高素质的核心管理团队和专业化的核心技术团队，开展行业动态讲座，强化师徒带教的人才培养模式，为员工搭建职业发展、学习成长的平台，完善公司各层级人才梯队建设工作，让员工与公司共同成长，持续进步。

在员工生活方面，公司通过持续开展“心温暖”民主对话会活动倾听员工心声；通过开展质量知识竞赛、邀请客户现场培训交流等方式，持续提升全员半导体气息意识；通过组织“锚定三年策，奋斗新征程”及“上下同欲，再攀高峰”等主题活动，关注员工生活、倾听员工心声、激发员工工作和生活热情，提高员工企业文化认同感。

2025 年公司持续实施股权激励计划，践行薪酬证券化长效激励机制，实施了新成长（三期）股权激励计划及 2025 年股票增值权激励计划，持续与员工共享公司发展红利，提升员工在企幸福指数。未来公司还会持续推行薪酬证券化的长效激励机制，不断吸引、聚集优秀人才，为公司未来长期稳定的可持续发展提供强有力的人才保障。

通过各项“深化半导体气息”工作的不断开展，目标是增强公司的生存成长能力和行业影响力，提升每一位员工的个人品格魅力和职业素养，最终实现企业竞争力的全面提升。

#### **4、聚焦战略投资，赋能高质量发展**

长期以来，公司专注于集成电路关键工艺材料领域深耕细作，精心谋划投资布局，致力于推动集成电路全产业链中设备制造及核心原材料供应企业的成长壮大，为整个产业链的升级与繁荣贡献力量。

报告期内，公司参与了由中芯聚源私募基金管理（上海）有限公司发起设立的股权投资基金——聚源启新股权投资基金（无锡）合伙企业（有限合伙），助力国家集成电路产业链的快速发展。为加深产业链上下游之间的合作，公司以自有资金参与了沪硅产业向特定对象发行股票的申购，并获得 3410283 股沪硅产业的股份。

公司在不断精炼和完善集成电路产业链布局的过程中，积极为产业链上的尖端技术、卓越产品和优秀团队注入活力，也将投资业务作为顺应公司发展战略、强化核心竞争力、赋能主营业务发展的重要抓手，实现“投资赋能主业，主业支撑投资”的良性循环。报告期内，公司完成浙江博来纳润电子材料有限公司、芯链融创集成电路产业发展（北京）有限公司的退出工作，取得部分投资收益。

上海新阳半导体材料股份有限公司

2026 年 3 月 11 日